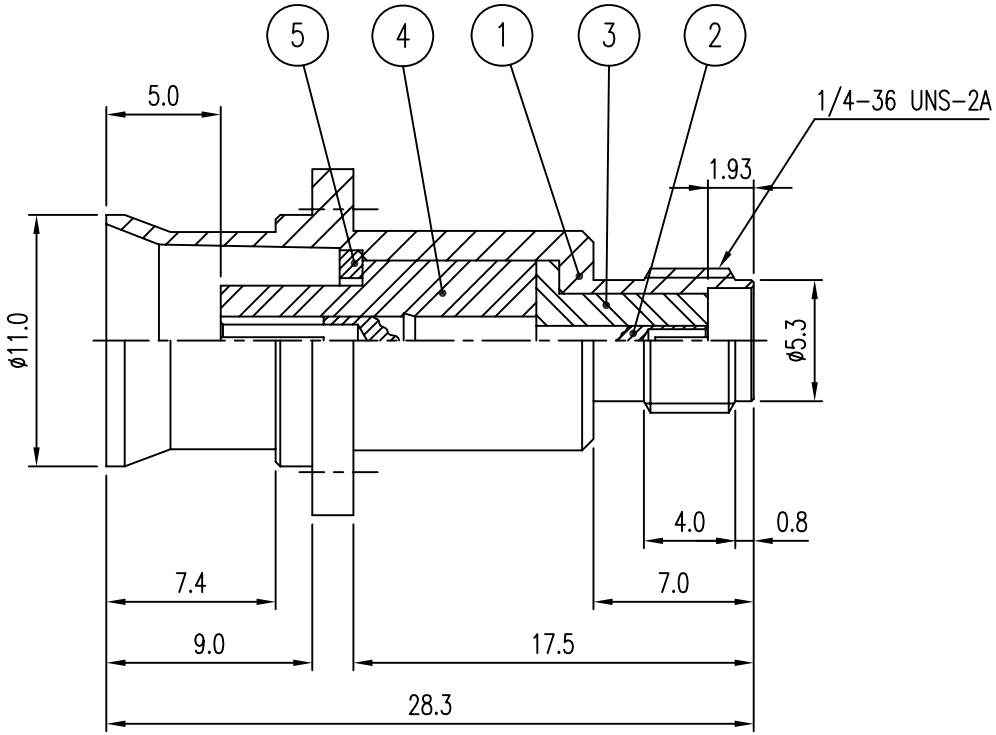
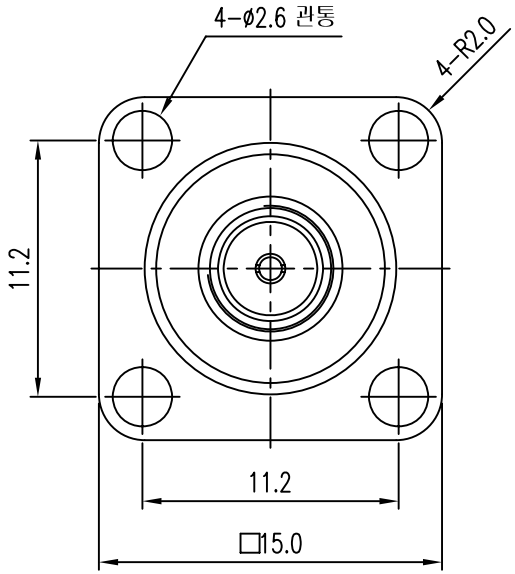
수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
5	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00051-5/1 (L7009)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00117-N/1
3	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00116-N/1
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DAC00012-5/1 (EA109)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DAD00027-5/1 (DA207)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2015. 11. 03.

승인 I.C.KIM

검도 S.M.LEE

제도 H.J.LEE

작성부서 연 구 소

척도 3/1 단위 mm 중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMA50 (J) TRU50 (J) 4H

A4

도번 AD00179-7/2

K361-519-002